

2007年 5月17日

報道関係各位

株式会社 構造計画研究所

構造計画研究所、電子機器設計者専用の熱流体解析ソフトウェア新版を販売開始 ～ 無類の最適化機能を搭載した「FLOTHERM バージョン7」～

株式会社 構造計画研究所（本社：東京都中野区、資本金 10 億 1,020 万円、社長：服部正太）は、電子機器向け熱設計専用の熱流体解析ソフトウェア「FLOTHERM（フローサーモ）」（開発元：英国 Flomerics（フロメリックス）Grp.社）の最新バージョンを販売開始しました。今回のバージョンアップにより、FLOTHERM は、半導体・コンピュータ・通信機器・自動車などの電子機器の熱設計をより精度よく、より効率よく行える パワフルなツールになりました。今回の「FLOTHERM バージョン7」発売は、構造計画研究所の Flomerics 社製品による売上拡大（今後1年で1億円を計画）に大きく寄与します。

「FLOTHERM バージョン7」の目玉は、他の CFD ソフトに類を見ない最適化機能が搭載されたことです。これまでのバージョンでは、ユーザがデザインパラメータの組み合わせを指定し、繰り返し使用することにより最適設計を導き出していたのに対し、新しく搭載された Response Surface Optimization 機能を用いると、設計空間全体を3次元の面グラフに落とし込み、デザインゴールに対する各パラメータの相互作用を統括的に視覚化し、短時間で精度よく最適値を特定することができます。

これにより、設計の見識を深め、デザインパラメータの感度を見極め、さらに製造変数の効果を即時に査定したりすることができます。この最適化機能の適用としては、ヒートシンクの設計、PCB コンポーネントの配置、ファン/送風機を選択と通風の位置などの検討などが挙げられます。

その他の新機能としては、以下が挙げられます。

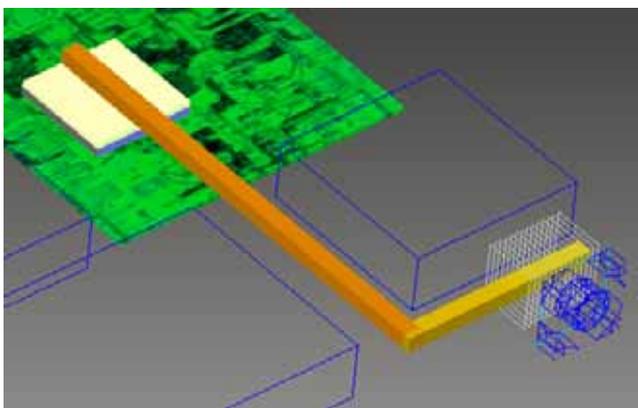
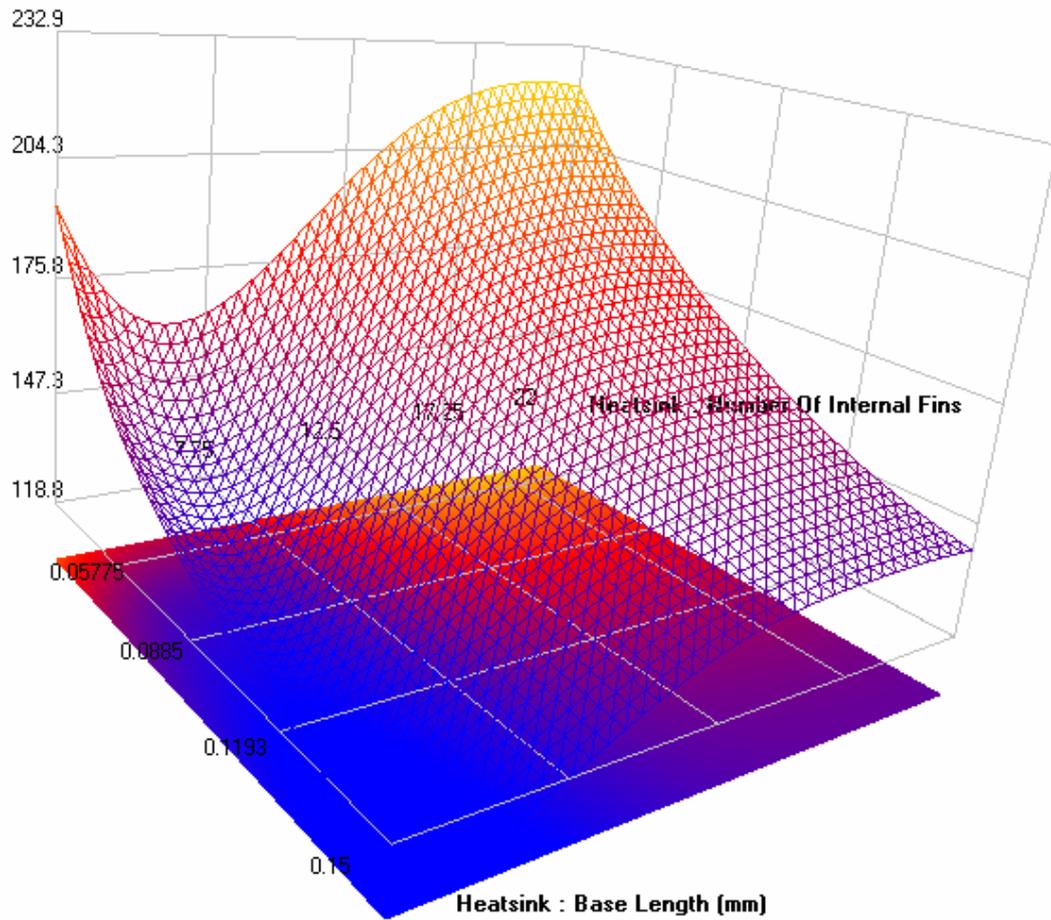
- 熱抵抗回路網
任意の熱伝導率をもつ熱抵抗回路網を扱うことができるようになりました。マルチチップモジュールのような内部密度レベルの高い半導体パッケージも、複数の熱抵抗を組み合わせることで、シンプルにかつ正確に表現することができます。さらに、熱抵抗回路網の熱容量を定義できるので、モデルの過渡応答を予測することができます。
- ヒートパイプモデル
Smart Part（Web からダウンロードできるライブラリ機能）に、ヒートパイプのモデルが新たに加わりました。小型化が進む家電製品で使われることが多くなってきたヒートパイプを、より詳細に取り扱うことができます。
- DXF ファイルの取扱
2次元の DXF ファイルをインポートし、ダイレクトに3次元モデルに変換する機能です。これは特に、主要な EDA ソフトウェアツールで作成されたプリント板における銅の配線パターン、パッド、およびビアを表すことに役立ちます。
- Visual Editor
Visual Editor は、これまで搭載されていた FLOMOTION に取って代わる、まったく新しいポストプロセッサです。これにより、連続視点移動を伴うアニメーションでよりリアルに流れや熱を映像化することができます。日本語のユーザーインターフェースがあります。

FLOTHERM 7 は、以下の展示会でご覧いただけます。

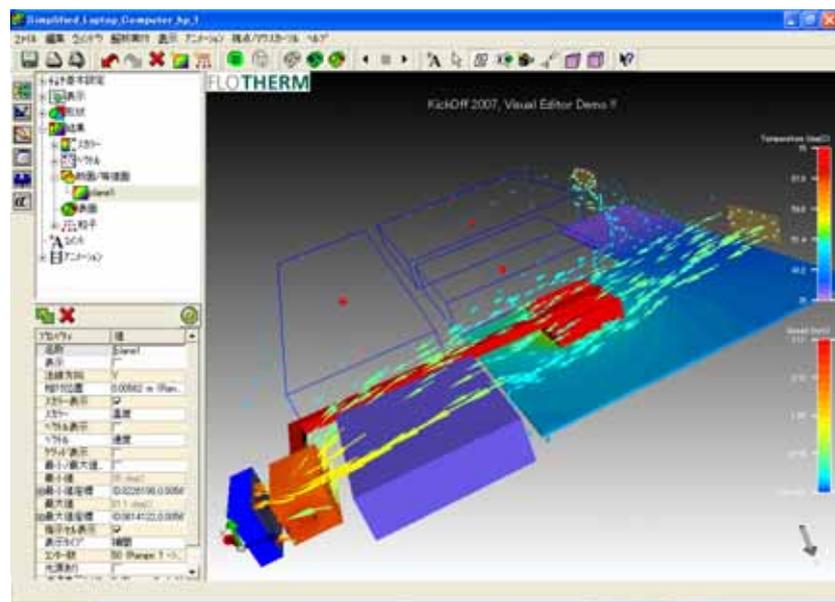
第18回設計・製造ソリューション展 2007年6月27日(水)~29日(金) 東京ビッグサイト

進化した最適化機能

U2 [Component] : Mean Solid Temperature (degC)



ヒートパイプモデル



Visual Editor (日本語版)

FLOTHERMについて

FLOTHERMは、世界で最初に開発された電子機器向け熱設計専用の解析ソフトウェアです。チップ・PCB・ヒートシンク・ファン・穴あき平板など、電子機器に特化した機能やユーザーインターフェースと、100万セルのモデルを1時間程度で安定的に計算することができる高速ソルバーを持ち、半導体・コンピュータ・通信機器・自動車などの主要メーカーに導入実績があります。

FLOTHERMの製品情報 <http://www.efd.jp/flo.html>

FLOTHERMの開発元、Flomerics社は、構造計画研究所の投資先であるNika(ニカ) GmbH社(独、フランクフルト)を2006年6月に買収しました。これに伴い、Nika社製品の日本総代理店である構造計画研究所は、これまで販売していたNika社のEFD製品に加え、新たにFLOTHERMなどのFlomerics社製品の取り扱いを始める運びとなり、電子機器・半導体を始め、家電・通信・自動車・航空機などの業界において、製品の高機能化・高密度化・納期短縮の対策として有効な“熱設計”を実現するツールのラインアップを増強し、精力的にマーケティング活動および販売活動を行っています。

構造計画研究所について

1959年設立。現在、ネットワーク、マルチメディア、情報通信、移動体通信分野から建設、製造分野に至るまでの広範かつ最新のIT技術を駆使したソフトウェア開発ならびにソフトウェアプロダクトを提供。さらにOR・シミュレーション手法を用いた工学・製造分野におけるコンサルティングサービスやマーケティング分野におけるコンサルティングサービスも行う。また建設・環境分野における数値解析コンサルティングサービスや建築・構造設計分野でも強みを発揮しており、様々な業界に対し、多様なソリューションを提供している。

本リリースの内容に関するお問い合わせは下記へお願い致します。		
	本ニュースの詳細について	ニュースリリース配信元
担当者	株式会社構造計画研究所 SBD営業部 ビジネス開発室 川村榮子	株式会社構造計画研究所 営業戦略部 佐藤仁宣、松本飛鳥
TEL	03-5342-1051(直)	03-5342-1032(直) 03-5342-1100(代)
FAX	03-5342-1055	03-5342-1222
e-mail	eiko@kke.co.jp	kkeinfo@kke.co.jp
住所	〒164-0011 東京都中野区中央4-5-3	〒164-0012 東京都中野区本町4-38-13
H.P.	http://www.sbd.jp/	http://www.kke.co.jp

構造計画研究所および、構造計画研究所のロゴは、株式会社構造計画研究所の登録商標です。その他の会社名及び製品名は、各社の商号、登録商標または商標です。